

NC 256 免清洗助焊剂 产品数据表

几乎零助焊残留
优异的焊接润湿性
可完全省去清洗工序

简介

NC 256 为免清洗型助焊剂，在回流焊后几乎无残留。回流过程中不会对相邻器件或焊球造成污染。该产品专为 CSP、BGA、倒装芯片及 PoP 等封装应用而设计，特别适用于无铅工艺。使用 NC 256 可省去清洗流程，并且与底部填充材料完全兼容。为避免底部填充过程中产生的污染，推荐与 YINCAE SMT 158HA 搭配使用；SMT 158HA 具有零析气特性。NC 256 与 SMT 158HA 联合使用可实现完全免清洗制程。NC 256 既适用于批量回流焊，也适用于返修工艺。

物理特性

产品名称	NC 256 免清洗助焊剂
外观	无色或淡黄色液体
未固化材料性能	
项目	数值
比重 (ASTM D1475-60)	0.9 – 1.1 g/cm ³
粘度 (Brookfield, 0.5 rpm)	3 – 10 kcP
卤素含量 (定量)	0 %
表面绝缘电阻 (J-STD-004)	合格 (Pass)

提取离子(MIL-STD-883E)	
Na ⁺	< 5 ppm
K ⁺	< 5 ppm
F ⁻	< 5 ppm
Cl ⁻	< 10 ppm

推荐固化工艺

NC 256 可通过点胶、丝网印刷或钢网印刷方式施加于器件焊盘位置;浸涂亦可作为可选工艺。

回流焊与固化

NC 256 完全兼容现有 SMT 装配工艺, 适用于多种焊盘表面处理, 包括 Ni/Au、化学银、OSP 等。可在空气或氮气气氛下, 使用热风对流、传导、红外或汽相焊接系统进行回流焊。

推荐回流曲线:

升温至峰值时间: 4 – 5 分钟

峰值温度: 230 – 260 °C

储存条件与保质期

在 0 °C 或以下条件下, 于原密封包装中储存, 保质期为 6 个月。超过该期限储存可能导致材料度升高。请防止材料受潮、挥发或混入异物, 否则可能对其加工性能产生不利影响。

安全信息

NC 256 为环保型、低毒性材料。在操作和使用过程中建议遵循常规工业卫生与安全规范。详细安全信息请参阅产品 安全数据表。

包装规格

NC 256系列浸渍胶黏剂有以下幾種型號 5 cc or 30cc 包装。其他包装形式可根据客户需求提供, 订购详情请联系 YINCAE。